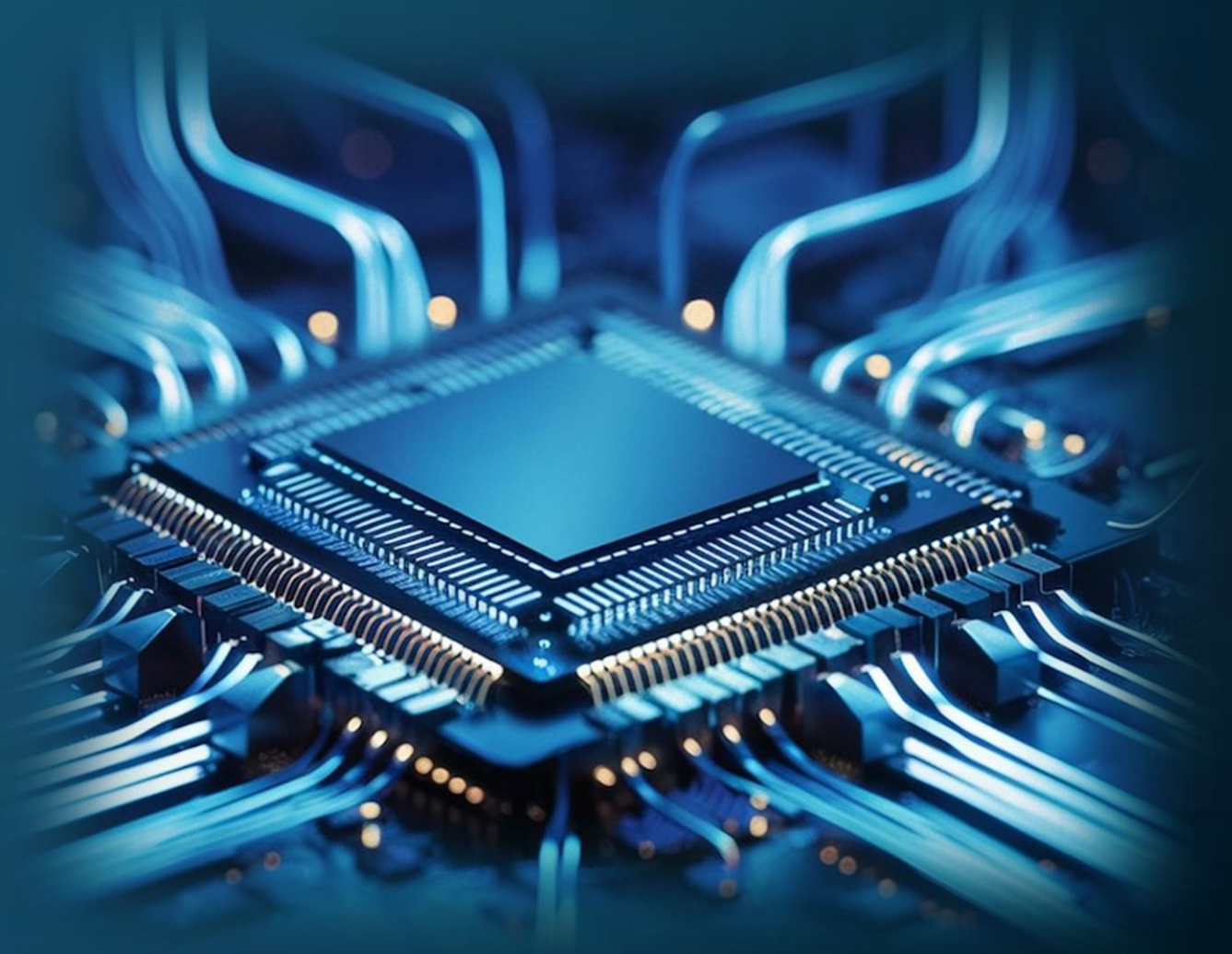




PRIORTECH

מצגת שוק הון
אוגוסט 2026



מטרת מצגת זו לספק אינפורמציה בלבד בנוגע לחברת פריורטק בע"מ ("החברה") ו/או החברות המוחזקות שלה.

מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה או איזה מהחברות המוחזקות שלה. המידע הנכלל במצגת אינו מהווה ייעוץ, המלצה, חוות דעת או הצעה באשר לכדאיות השקעה ואינו בא במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע. מצגת זו אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלבנטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות ערך של החברה.

המצגת כוללת נתונים ומידע המוצגים באופן ובעריכה שונה מהנתונים הנכללים בדיווחים הפומביים או ככזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחים הפומביים. על כן, מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ובכלל זה, בתשקיף מדף, בדוחותיה העיתיים של החברה או בדיווחיה המידיים של החברה. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו ובין האמור בדיווחיה של החברה יגבר האמור בדיווחים האמורים.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים, כוונות ונתונים נוספים המתייחסים לאירועים עתידיים המהווים "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בסעיף 32א בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, המבוסס על תחזיות, ציפיות והנחות סובייקטיביות כפי שידועות לחברה במועד הכנת מצגת זו. ההערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, ויכול שתושפענה מגורמים שאינם בשליטת החברה ושלא ניתן להעריכם מראש באופן סביר במועד, לרבות אבל לא רק, בשל: (א) האטה בצמיחה הכלכלית ככלל והאטה בפעילות בשווקי האלקטרוניקה והשבבים בפרט, עיכובים בשרשרת האספקה ועלויות מחירי הובלה, עלויות במחירי חומרי גלם, הפרעות ועיכובים בהתקנות של המוצרים באתרי לקוחות, עיכובים והפרעות לתהליכי ייצור, שיווק ומחקר ופיתוח, וכן הפרעות ועיכובים בייצוא או ייבוא של רכיבים ומוצרים,

בין השאר בשל הטלת מגבלות תנועה או חסימת נתיבי שיט בטריטוריות בהן פועלות החברה ו/או החברות המוחזקות שלה; (ב) תלות בצדדים שלישיים וקיום הסכמים על ידי צדדים שלישיים עימם התקשרה החברה ו/או מי מהחברות המוחזקות שלה; (ג) התפתחויות רגולטוריות ומדיניות ממשלתית, בעיקר בשל פעילותן חברות הקבוצה בטריטוריות ברחבי העולם ובעיקר במזרח אסיה; (ד) חוסר יציבות באזורי פעילות גלובלית והשפעת משברים פוליטיים, כלכליים וגא-פוליטיים על תעשיית המוליכים למחצה והמתח בין ארה"ב לבין סין; (ה) ההיצע העולמי של רכיבים אלקטרוניים ויכולתן של החברות המוחזקות לרכוש רכיבים אלקטרוניים לצורך שימור היתרון התחרותי שלהן; (ו) גידול בעלויות תפעוליות; (ז) עלויות ייצור גבוהות של לקוחות אשר עלולות להביא לעיכוב ברכישת מוצרים של החברות המוחזקות; (ח) גורמי הסיכון המפורטים בדוח השנתי של החברה לשנת 2025 שפרסמה החברה ביום 31.3.2026 (מספר אסמכתא 2026-01-030459).

לפיכך, תוצאות או ביצועים עתידיים בפועל של החברה או החברות המוחזקות שלה עשויים להיות שונים מהותית מכפי שנצפה או כפי שמתפרש במצגת זו.

למעט כפי שיידרש על פי דין, החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות מצגת זו ו/או לעדכן ו/או לשנות נתונים ו/או תחזיות ו/או הערכות שנכללו בה על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

חלק מהמידע הכלול במצגת (כולל שווקים ומגמות) מבוסס או נגזר מנתונים שהחברה אספה מצדדים שלישיים בלתי תלויים שהחברה אינה יכולה לערוב לנכונותם היות ולא בדקה את הנתונים בעצמה.

כמו כן, מובהר כי אין בביצועי העבר של החברה ו/או החברות המוחזקות שלה המוצגות במצגת זו כדי להוות אינדיקציה לתוצאות העתיד ואין כל וודאות כי החברה ו/או החברות המוחזקות שלה יגיעו לתוצאות דומות או יוכלו ליישם את אסטרטגיית ההשקעה שלהן או להשיג כל יעד השקעה.



PRIORTECH

תוצאות Q2-26

YTD 2026

\$23.1M

Q2-26

\$12.2M

רווחי
אקוויטי

YTD 2026

\$23.1M

Q2-26

\$7.0M

רווח
נקי

חוב פיננסי, נטו

\$55.8M

הון עצמי

\$287M

תחזית שוק הסמיקונדקטור

**אנליסטיים מעריכים
שתעשיית הסמיקונדקטור
תגיע השנה להיקף מכירות
של 1.5-1.6 טריליון דולר –
זינוק של כ- 90% לעומת
שנת 2025**

תחזיות ארגוני המחקר המובילים עודכנו לאחרונה וצופות **מכירות עולמיות של כ- 1.5-1.6 טריליון דולר** בשנת 2026 – **זינוק שנתי** חסר תקדים של **90%-92%** לעומת שנת 2025, וניפוץ רף האחד טריליון דולר שבעבר צפו כי יתממש רק בשנת 2030.*



המנוע העיקרי לצמיחה בשוק מגיע מרכיבי Logic, מרכיבי זכרון (בעיקר HBM), מרכיבי חומרה נוספים הנדרשים ל-HPC ומתאימים לחוות שרתים ולמחשוב קצה יעודי, בעיקר עקב **התרחבות השימושים של יישומי AI**.



שבבי AI (מאיצים, מעבדים ורכיבי תקשורת) צפויים להוות כ-**36% מכלל מכירות השבבים בעולם, בשנת 2026 וכ- 50% בשנת 2030**. כמו כן, צפויה צמיחה בכל האיזורים הגיאוגרפיים ובכל קטגוריות המוצרים.



גורמי הסיכון המשמעותיים לטווח הרחוק הינם **עודף כושר ייצור** שייווצר בעקבות הגדלת כושר הייצור בשנים הקרובות, לטווח הקרוב קיימים גורמי סיכון שקשורים **במתיחות פוליטית** (בעיקר ארה"ב-סין), **מלחמות אזוריות**, הטלת **מכסים** בין מדינות, ותלות באספקת **חומרי גלם**.



תיאור המצב העסקי של החברות הכלולות



Camtek
See Beyond

ACCESS



PRIORTECH



 **ACCESS**

AMITEC/ACCESS

המצב העסקי של אקסס

הרבעון השני של 2026 ממשיך את המגמה מסוף שנת 2025 ומציג **מכירות של כ-113 מיליון דולר** עם רווחיות נקייה של כ-20%. 

אקסס מעריכה כי מגמת הצמיחה תימשך גם בשנת 2027. אקסס עברה שינוי הדרגתי וממקדת את המוצרים שלה בתחום המודולים ל power devices **למחשבי HPC המיועדים ליישומי AI** וכן במצעים לתחום הפוטוניקס ומרחיבה את כושר הייצור בהתאם.



תחום רכיבי ה-RF
סובל עדיין מהביקושים הנמוכים לטלפונים סלולריים, אולם רשם שיפור במכירות ואחראי ל-36% מהמכירות.



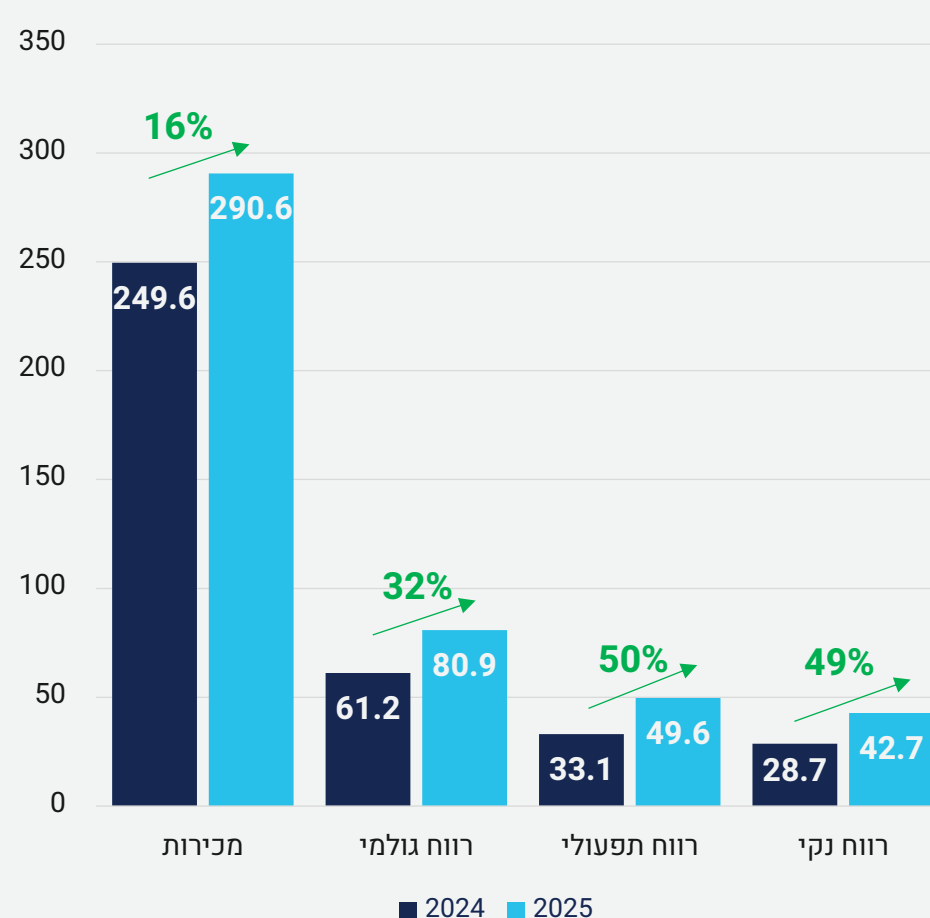
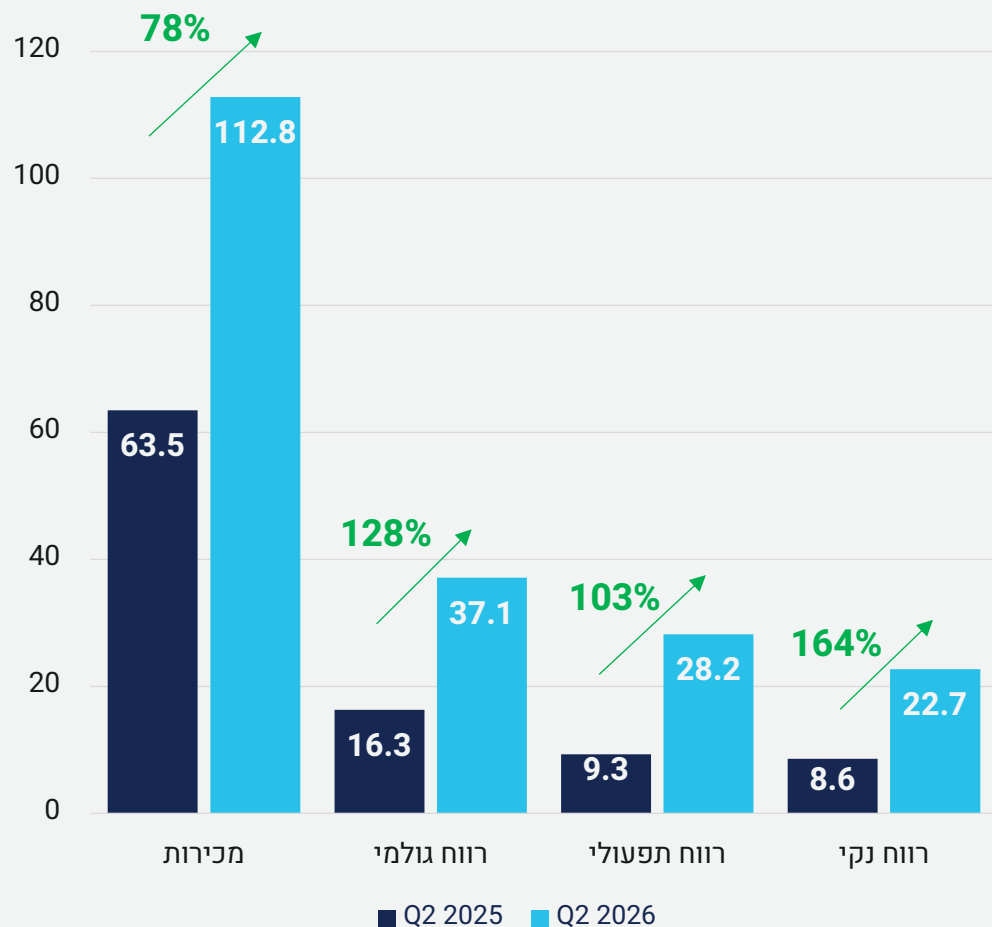
תחום מצעי ה-ASIC
עבור יישומי **מטבעות וירטואליים**, סובל מירידת מחירי הביטקוין.



תחום רכיבי ה-Power Device
הפך להיות **תחום משמעותי ומוביל** באקסס, בעיקר בזכות הביקושים לרכיבים המשולבים **במחשבי ה-HPC**, המשמשים בעיקר ב- **Data centers ליישומי AI**. תחום זה אחראי לכ-61% ממכירות אקסס ברבעון השני.

אקסס ממשיכה לפעול לקידום ההליך אל מול רשות ני"ע הסינית והבורסה בשנזן, ומעריכה כי ההנפקה והרישום למסחר יושלמו עד לסוף הרבעון הרביעי.





YTD 2026 REVENUE

Power Device (AI
data centers) 57%

RF (Mobile)
37%

ASIC (Crypto)
4%

FCBGA 2%

Q2 2026 REVENUE

Power Device (AI
data centers) 61%

RF (Mobile)
36%

ASIC (Crypto) 1%

FCBGA 2%

Camtek



CAMTEK



קמטק צופה שהביקוש בתחום הרכיבים עבור המחשבים עתירי הביצועים ה- **HPC** ימשיך להיות **מנוע הגידול העיקרי** של קמטק. קמטק קיבלה, מתחילת השנה ועד ליום 16 לאוגוסט 2026, הזמנות בהיקף של למעלה מ- **600 מיליון דולר**.

קמטק מחזיקה במעמדה כיצרנית **מובילה** של מערכות בדיקה **למאזנים מתקדמים ורכיבים בתחום ה- HPC**, האחראיות לכ- **50%** ממכירותיה ברבעון השני של 2026. ההערכות בתעשייה הן שקצב הגידול השנתי, בשנים הקרובות, בביקוש לרכיבי HBM ו- Chiplets יהיה **דו ספרתי**.

המוצרים החדשים של קמטק ה- **Eagle G5** וה- **Hawk** פותחו כדי לענות על טכנולוגיות המאזנים המתקדמות, תרמו ברבעון השני של 2026, לכ- **50%** ממכירות קמטק.

קמטק מפתחת את **תחום החדשנות** באמצעות השקעות משמעותיות בפיתוח פלטפורמות מתקדמות, אלגוריתמים חדשניים **מבוססי בינה מלאכותית (AI)** ויכולות תוכנה פורצות דרך.



\$133M

**מכירות רבעון שני
שנת 2026 עומדות
על כ-**

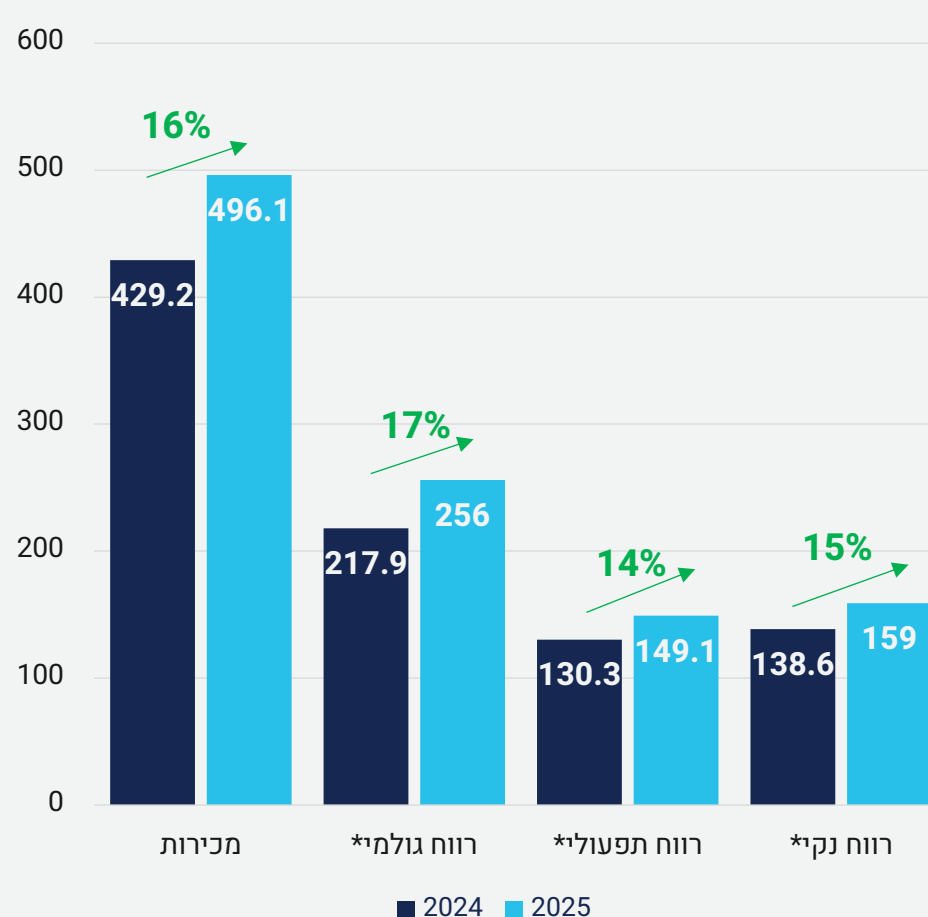
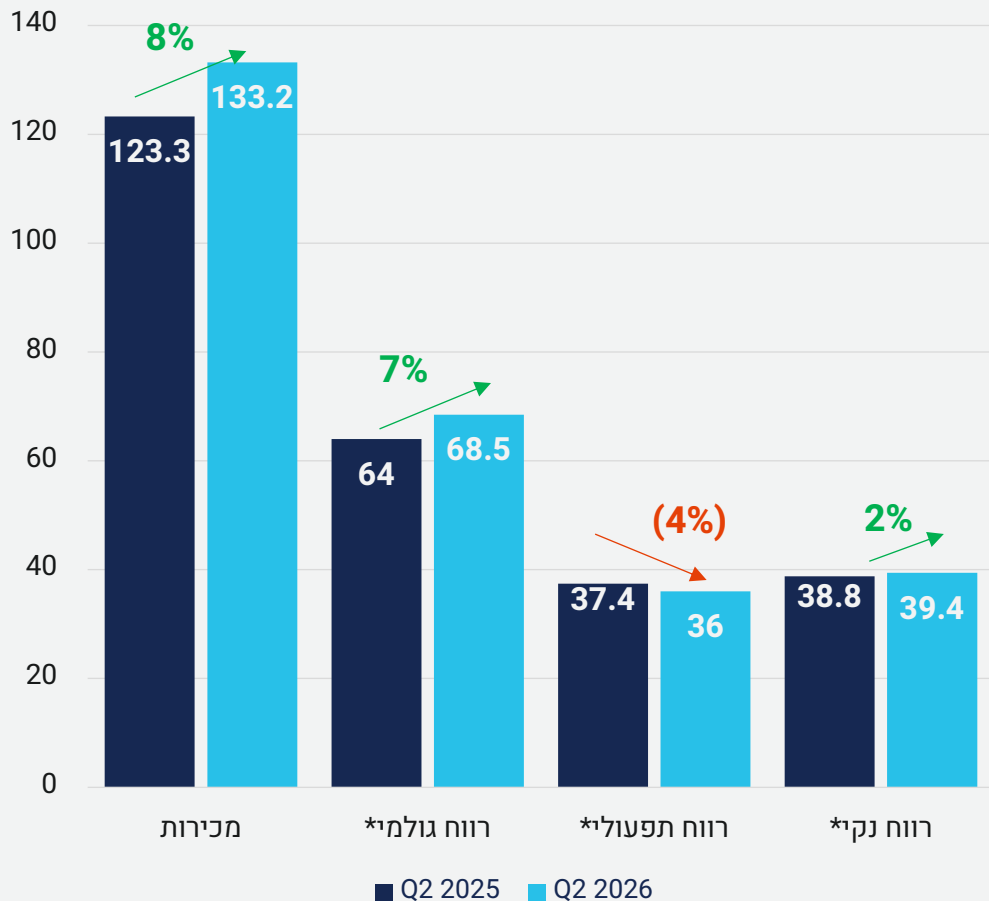
**\$158M-
160M**

**צפי המכירות
לרבעון השלישי
של 2026 עומד על
כ-**



שנת 2026 צפויה להיות שנת צמיחה נוספת - הגידול בהכנסות צפוי להיות בעיקר במחצית השנייה של השנה ומוערך בכ- 30% לעומת המחצית הראשונה של 2026.

קמטק - תוצאות רבעון שני 2026 (Non-GAAP)



פריוורטק - סיכום



קמטק ביססה את מעמדה כמובילה עולמית בתחום בדיקת הרכיבים למחשבים עתירי הביצועים (HPC) המיועדים לאפליקציות AI, אחד התחומים הצומחים והמרתקים בעולם הטכנולוגיה.

קמטק מאמינה שטכנולוגיות המארזים החדשות, Hybrid bonding and micro copper bumps, תהווה עבור קמטק הזדמנויות צמיחה משמעותיות בשנים הקרובות.



אקסס היא החברה המובילה בסין בתחום המצעים המתקדמים, ומבססת את מעמדה כשחקנית חשובה בייצור מודולים של power devices לשוק ה-HPC ליישומי AI.

מנוע הצמיחה המרכזי של אקסס הוא תחום המארזים המתקדמים ל-Power Devices (ECP). מארזים אלו מותקנים במחשבי ה-HPC של החברות המובילות בעולם, המשמשים להרצת אפליקציות של AI.



מונחים מקצועיים

הגדרות

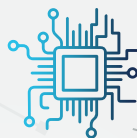
(HPC) High Performance Computer

מחשבים חזקים במיוחד כדי לפתור בעיות חישוב מתקדמות, המתבססים על מארזים מתקדמים מסוג Chiplet או Heterogeneous Integration שתומכים בישומי AI וכוללים זיכרונות DRAM מסוג HBM שהם 8 שכבות של ציפים מסוג Dram שמורכבים אחד על השני.



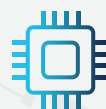
(HI) Heterogeneous Integration

אינטגרציה של רכיבי סמיקונדקטור המיוצרים בנפרד במכלול ברמה גבוהה יותר, אשר, במצטבר, מספקת פונקציונליות משופרת ומאפייני פעולה משופרים.



Chiplet

ציפלט הוא יחידת עיבוד משנית, הנשלטת בדרך כלל על-ידי בקר קלט/פלט הנמצא באותו מארז. ארכיטקטורת הציפלט היא גישה מודולרית לבניית מעבדים. אינטל ו-AMD, יצרני המעבדים המובילים בעולם, מאמצים את ארכיטקטורת הציפלט לקו המוצרים הנוכחי שלהם.



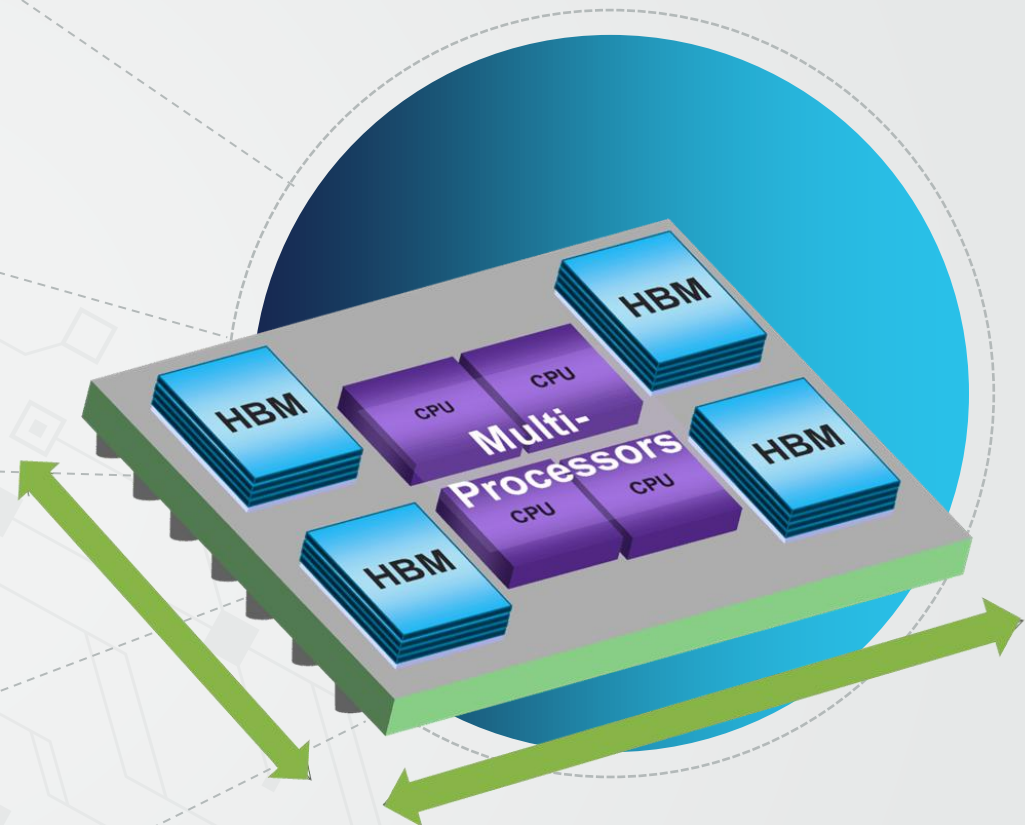
(HBM) High Bandwidth Memories

זיכרון רוחב פס גבוה, הוא ממשק זיכרון מחשב מהיר עבור זיכרון דינמי מוערם בתלת-ממד.



FC-BGA

מערך כדורי על מצע אריזת מוליכים למחצה בצפיפות גבוהה, המאפשר יותר פונקציות לשבבי LSI במהירות גבוהה.



מונחים מקצועיים

הגדרות (המשך)

מאריזי ECP

מאריזים המכילים רכיבים של Power devices שמונחים על מצע אורגני קבור, החיבור בין הרכיבים נעשה על ידי רשת של מוליכים (RDL) במספר שכבות. המאריז הוא חלק מסגמנט ה Advanced Packaging והוא מוגן במספר פטנטים רשומים שאקסס רשמה



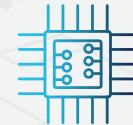
RDL

Redistribution layers - רשת של מוליכים דקים בין 2 ל 12 מיקרון שמחברת בין הרכיבים במספר שכבות של הולכה.



Via First

זו הטכנולוגיה הבסיסית שפותחה באמיטק ומיושמת באקסס מיום הקמתה, בטכנולוגיה זו החיבור בין השכבות השונות נעשה דרך pillars שמישמים בתחילה ורק לאחר מכן מניחים את השכבה, להבדיל מהטכנולוגיה הרגילה בה חורי המעבר (Via) נקדחים ומצופים לאחר הנחת השכבה.



PMIC

Power management Interconnect – רכיבי Power Devices הצורכים זרמים גבוהים ונמצאים בסקלה הגבוהה של המחירים והאיכויות.



Pick&place

טכנולוגיה של השמת רכיבים על מצעים בצורה מאוד מדויקת ובתפוקה גבוהה.



ASIC

מעגל משולב או שבב המיועד ליישום ייחודי ומסוים, להבדיל ממעגלים משולבים תקינים לשימוש כללי. למשל, שבב שנבנה במיוחד ליישום של טלפון סלולרי מסוים או ליישום של מחשוב למטבעות קריפטוגרפיים, נחשב ל-ASIC.

